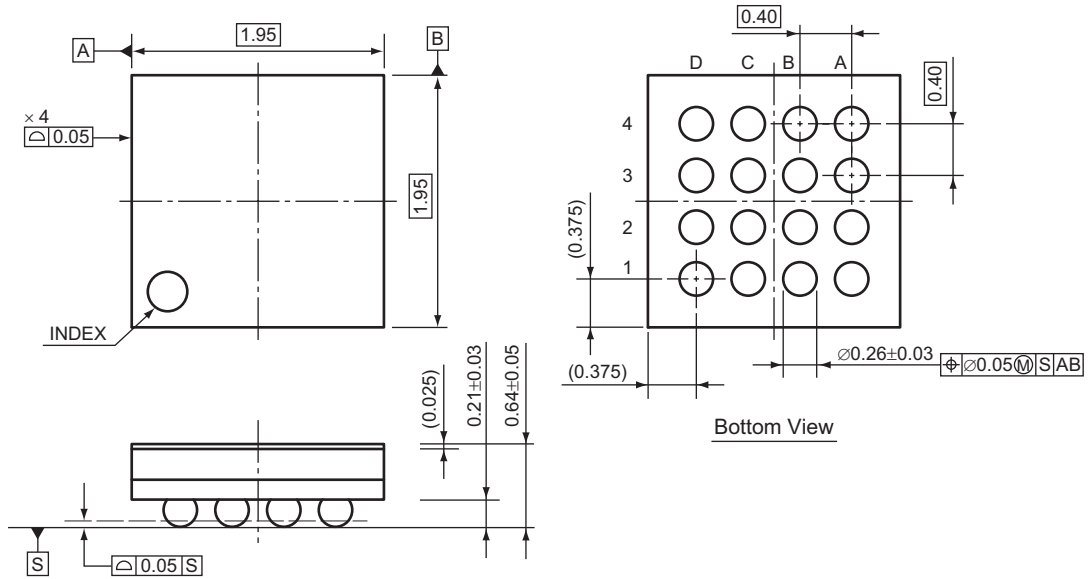


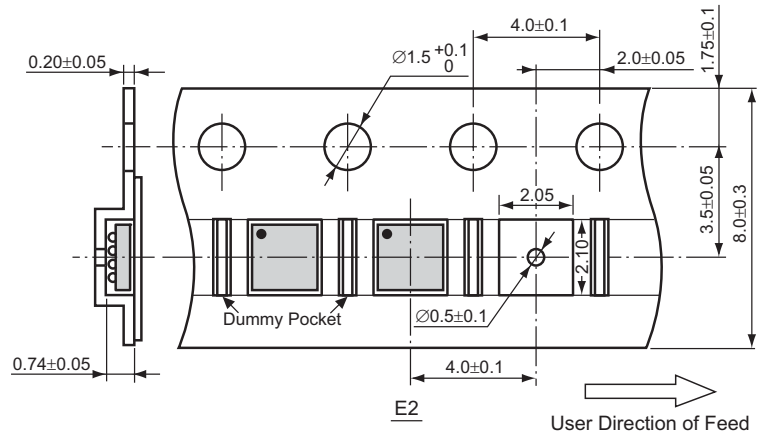
WLCSP-16-P1

(単位: mm)

■ パッケージ外形図

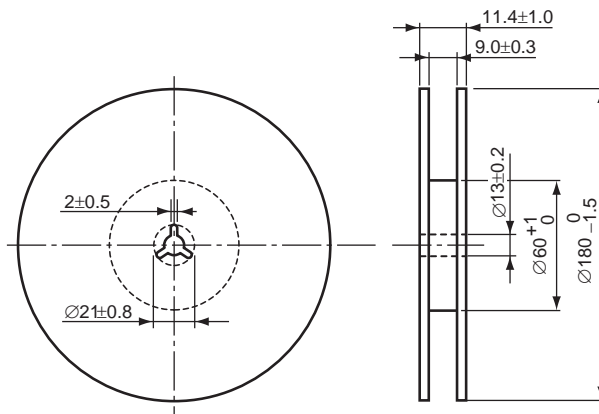


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=5000 個)



■ 許容損失について (WLCSP-16-P1)

WLCSP-16-P1パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

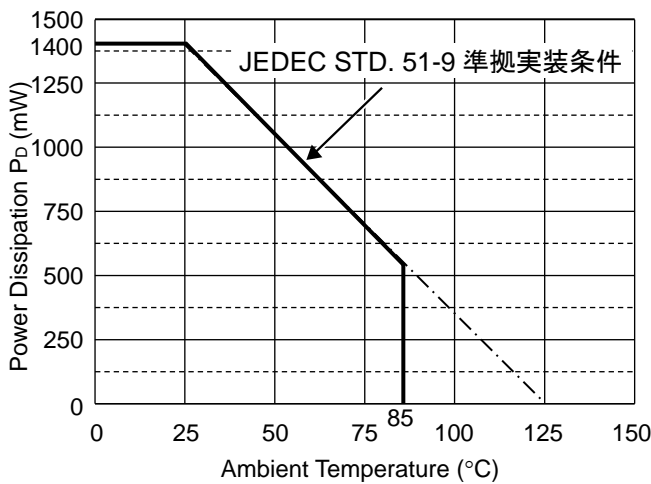
測定条件

JEDEC STD. 51-9 準拠実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	101.5mm×114.5mm×1.6mm
配線率	表裏層 : 配線率 60%以下 内層 : 配線率 100%

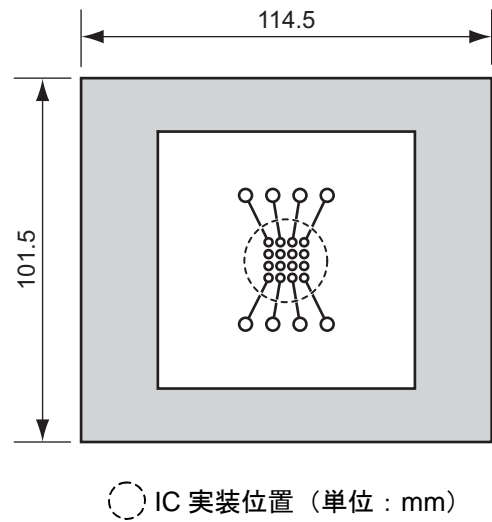
測定結果

(Ta=25°C, Tjmax=125°C)

JEDEC STD. 51-9 準拠実装条件	
許容損失	1400mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/1.4\text{W} = 71^\circ\text{C/W}$

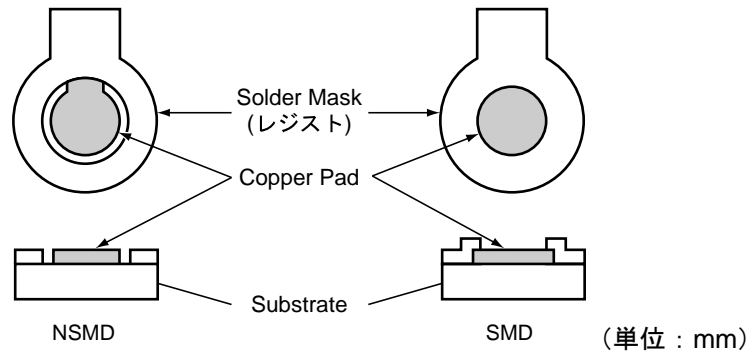


許容損失 対 周囲温度



基板レイアウト

■ 基板パッド推奨寸法 (WLCSP)



NSMD and SMD Pad Definition

Pad definition	Copper Pad	Solder Mask Opening
NSMD (Non-Solder Mask defined)	0.20mm	MIN. 0.30mm
SMD (Solder Mask defined)	MIN. 0.30mm	0.20mm

- *) パッド寸法の最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。
- *) ステンシル開口部 (推奨) … φ0.3mm
- *) Pbフリー製品については、共晶半田ペーストには実装しないようにして下さい。